

Electrochemical Migration on the Interconnection Networks Used in Microelectronics, part 2.

Dr. Gábor Harsányi, DSc, Dr. Bálint Medgyes, PhD
Dr. László Gál, Dr. Miklós Ruzinkó

Budapest University of Technology and Economics, Dept. Of Electronics technology

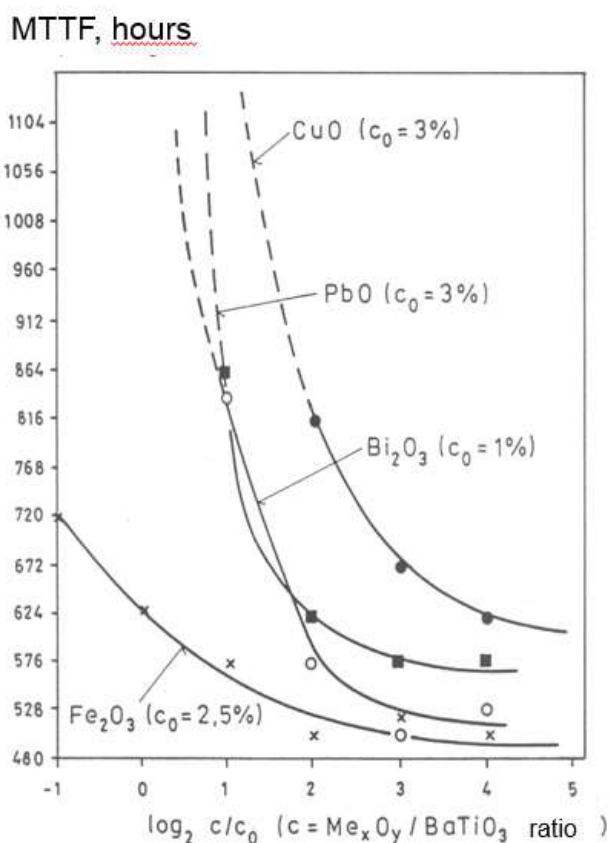
Kutatási beszámoló

2018. január 31.

Az elektrokémiai migráció redukálódott szigetelőkomponensek esetén. A lehetséges elméleti modellek felállítás. A virtuális migráció modellje. Kísérleti bizonyítékok: kerámia alapú és vastagréteg kondenzátorok meghibásodása migrációnak ellenálló fémmezések esetén. Közepes meghibásodási ráták alakulása gyorsított élettartam vizsgálatoknál. Az összetevők koncentrációjának és a technológiai paramétereknek a hatása. A fémes állapot létrejöttének kísérleti bizonyítékai: fotoelektron-spektroszkópiai és röntgen-diffrakciós vizsgálatok.

http://www.ett.bme.hu/download/electrochemical_migration_on_the_interconnection_networks_used_in_microelectronics_part_2

MTTF
(Mean Time to Failure)
data of thick-film
capacitors as a
function of the
dielectrics composition
(95%RH, 40°C, 10VDC)



WE CONNECT CHIPS AND SYSTEMS